

Medienmitteilung

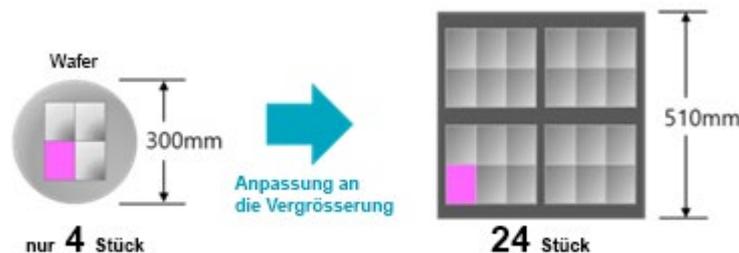
Flamatt, 4. September 2025

Comet tritt dem JOINT3-Konsortium bei

Comet gab heute den Beitritt zum JOINT3-Konsortium ("JOINT3") über ihre Division IXS bekannt. Das Konsortium strebt die Entwicklung der nächsten Generation von Halbleiterverpackungen an. Darin spiegelt sich die Strategie von Comet wider, den Anwendungsbereich ihrer Röntgentechnologien zu erweitern und das Unternehmen an der Spitze der Innovation im Bereich Halbleiterverpackung und -inspektion zu positionieren.

JOINT3 ist ein von Resonac Corporation (Präsident und CEO: Hidehito Takahashi, im Folgenden "Resonac") ins Leben gerufene Partnerschaft für die gemeinsame Entwicklung von Materialien, Anlagen und Design-Tools, die für organische Interposer auf Panelebene optimiert sind. JOINT3 bringt weltweit führende Unternehmen aus der Halbleiterlieferkette zusammen. Mit Hilfe einer Prototyp-Linie für organische Interposer im Format 515 x 510 mm fördert das Konsortium die Entwicklung von Materialien, Anlagen und Design-Tools, die für organische Interposer auf Panelebene optimiert sind.

Bei herkömmlichen Fertigungsmethoden werden rechteckige Teile aus runden Wafern geschnitten. Da die Interposer jedoch immer grösser werden, nimmt die Stückzahl, die aus einem einzigen Wafer hergestellt werden kann, ab, was zur Herausforderung wird. Um dieses Problem zu lösen, gewinnt ein Herstellungsverfahren, das von kreisförmigen Waferformen zu quadratischen Plattenformen übergeht, an Aufmerksamkeit, da es die Herstellung einer grösseren Anzahl von Interposern aus einer bestimmten Waferfläche ermöglicht.



Mit dem kürzlich vorgestellten Röntgensystem CA20 hat Comet neue Massstäbe für die zerstörungsfreie 3D-Prüfung von Wafern und modernen Halbleiterverpackungen gesetzt. Das speziell für die Industrie entwickelte System liefert eine Submikrometer-Auflösung durch modernste Computerlaminographie und deckt in Sekundenschnelle Defekte auf, für deren Erkennung bisher Wochen erforderlich waren. Von Chipllets bis hin zu HBM-Stapeln – CA20 ermöglicht die "More-than-Moore"-Zukunft mit beispielloser Auflösung und Geschwindigkeit.

Im Rahmen des JOINT3-Konsortiums wird Comet ihre Expertise in fortschrittlichen Röntgensystemen einbringen, um die Grenzen der Inspektionsmöglichkeiten über die traditionelle Lötstellenanalyse hinaus zu erweitern. Während sich die ersten Anwendungen auf Mikrobumps konzentrierten, ist der Anwendungsbereich viel breiter und kann bisher nicht vorstellbare Technologien ermöglichen. Diese neuen Erkenntnisse werden den Partnern des Konsortiums einen entscheidenden Vorteil bei der Entwicklung der Halbleiterinnovationen von morgen verschaffen.

"Die Beteiligung am JOINT3-Konsortium bekräftigt unser Engagement, die Zukunft der Halbleiterfertigung mitzugestalten", so Dionys van de Ven, Division President X-Ray Systems (IXS) bei Comet. "Wir gehen nicht nur auf die Bedürfnisse heutiger Anwendungen ein, sondern engagieren uns auch aktiv für Technologien, die noch im Entstehen begriffen sind und die Industrie von morgen bestimmen werden."

Übersicht über JOINT3

Name	JOINT3 (JOINT: Jisso Open Innovation Network of Tops)
Ziele	Beschleunigung der Entwicklung von Materialien, Geräten und Design-Tools, die für organische Interposer auf Plattenebene optimiert sind, durch gemeinsame Entwicklung mit den teilnehmenden Unternehmen.
Teilnehmende Firmen (alphabetisch)	27 Firmen (Stand 3. September 2025): Resonac Corporation, AGC Inc., Synopsys, Inc., Applied Materials, Inc., ASMPT, Brewer Science, Inc., Canon Inc., Comet Yxlon, EBARA CORPORATION, Furukawa Electric Co., Ltd., Hitachi High-Tech Corporation, JX Advanced Metals Corporation, Nippon Mining & Metals Corporation, Kao Corporation, Lam Research, LINTEC Corporation, MEC COMPANY LTD., Mitutoyo Corporation, NAMICS Corporation, Nikko-Materials Co., Ltd., OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD., Tokyo Electron Ltd., Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd., TOWA Corporation, ULVAC, Inc., Ushio Inc., ZUKEN Inc., 3M Company
Standort	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Panel Level Interposer Center "APLIC" (Yuki City, Ibaraki Präfektur, Japan (innerhalb der Resonac Shimodate Anlage (Minami-yuki))) Packaging Solution Center (Kawasaki City, Kanagawa Präfektur, Japan)
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung von Materialien, Ausrüstungen und Design-Tools für organische Interposer unter Verwendung einer Prototyp-Produktionslinie auf Plattenebene (515 x 510 mm) Förderung der Entwicklung durch gemeinsame Entwicklung, indem Material- und Ausrüstungshersteller gemeinsame Prototypen herstellen lassen Nutzung von JOINT3 als "Trainingsgelände" für Technologie- und Ausrüstungshersteller zur weiteren Verbesserung der Technologien für organische Interposer auf Plattenebene

Das APLIC Gebäude (Aussenansicht)



Kontakt Comet

Dr. Ulrich Steiner
VP Communications, Investor Relations & Sustainability
T +41 31 744 99 95
ulrich.steiner@comet.ch

Kontakt Resonac

Resonac Holdings Corporation
Media Relations Group, Brand Communication Department
Phone: +81-3-6263-8002

Comet

Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Resonac

Resonac ist ein Spezialchemieunternehmen, das aus der Integration von Showa Denko und der ehemaligen Hitachi Chemical im Januar 2023 hervorgegangen ist. Die Umsatzerlöse des Unternehmens im Bereich Halbleiter- und Elektronikmaterialien beliefen sich 2024 auf rund 450 Milliarden Yen. Das Unternehmen ist weltweit führend, insbesondere bei Halbleitermaterialien für Verpackungsprozesse. Durch die Integration der beiden Unternehmen ist Resonac in der Lage, Materialfunktionen zu entwerfen und selbst zu entwickeln, beginnend bei den Rohmaterialien. Der Markenname "RESONAC" ist eine Kombination aus zwei englischen Wörtern, nämlich dem Wort "RESONATE" und "C" als Anfangsbuchstabe von CHEMISTRY. Das Unternehmen wird das Beste aus seiner co-kreativen Plattform machen und die technologische Innovation mit Halbleiterherstellern, Materialherstellern und Geräteherstellern innerhalb und ausserhalb Japans beschleunigen.

Einzelheiten finden Sie auf der Website der Resonac Holdings Corporation: <https://www.resonac.com/>